|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE PRODUCTO**  **REFERENCIA**  **PROCESO** | | Mufla 27L 220VAC  JPMN27 | | | | **MODELO**  **ORDEN DE PEDIDO**  **ORDEN DE PRODUCCIÓN** | | | **2019**  **2019131**  **2019131-E** | | |
| **No.** | **ACTIVIDAD** | | | **CONTROL ACTIVIDAD** | | | **REALIZADO POR** | | | **REVISADO POR** | **FECHA** |
| **FECHA** | **OPERARIO** | |
| 1 | Perforación de los agujeros de sujeción de la PCB, con broca de diámetro de 5/32” | | | Verificar que la perforación tenga el diámetro adecuado | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 2 | Soldadura de condensadores de Tantalio SMD | | | Verificar que los condensadores SMD tengan la ubicación correcta de acuerdo a la polaridad | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 3 | Soldadura de resistencias | | | Verificar que las resistencias tengan la orientación definida en el manual de ensamble, verificar la unión de dos capas en alguno de los terminales de las resistencias. | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 4 | Soldadura de componentes pasivos y activos (condensadores, cristales de quarzo, reostatos) | | | Verificar que los valores de los componentes coincidan con el esquemático. Además verificar el sentido de los componentes. Verificar visualmente la soldadura | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 5 | Soldadura de conectores GP | | | Verificar que el sentido del GP corresponda a lo establecido en el manual de ensamble electrónico. Verificar visualmente la soldadura | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 6 | Soldar los componentes con empaquetado TO-220 | | | Verificar que la referencia de cada componente coincida con el esquemático y la orientación del mismo. Verificar visualmente la soldadura | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 7 | Soldadura de Borneras | | | Verificar que las borneras queden en el sentido correcto y sean de la cantidad de pines de acuerdo al esquemático. Verificar visualmente la soldadura | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 8 | Soldadura de circuitos Integrados | | | Verificar que se encuentre soldada correctamente sin separaciones de la regleta en la capa top. Verificar visualmente la soldadura. Verificar que la soldadura de CI sin regleta se encuentre en el sentido correcto. | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 9 | Realizar la etapa de pruebas de funcionamiento de la tarjeta, siguiendo los lineamientos del manual de ensamble electrónico | | | Verificar que las mediciones obtenidas en la etapa de pruebas de la tarjeta correspondan a las mediciones esperadas de acuerdo al manual de ensamble. | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| 10 | Realizar la preparación de la caja eléctrica del equipo y el cableado de la misma | | | Verificar que los componentes y el sistema de organización de cables se encuentren ubicados de forma correcta basada en las indicaciones de montaje por parte del área de ingeniería. Verificar que las conexiones se encuentren de acuerdo al plano eléctrico. | | |  |  | | Diseño Electrónico |  |
| **Despeje de línea realizado por:**  **Fecha:** | | | **Despeje de línea verificado por:**  **Fecha:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  VoBo DIRECTOR TÉCNICO Fecha | | | | | | |

**NOTA: ADICIONE A ESTE FORMATO EL ANEXO 1 DEL MANUAL DE ENSAMBLE ELECTRÓNICO.**